

2025年中国一体成型电感行业概览： 从算力基建到电动化浪潮，一体成型 电感重塑高端应用边界

(精华版)

2025 China Integrated Inductor Industry

2025 年中国一体型インダクタンス産業

报告标签：一体成型电感、金属磁粉芯、量价齐升

撰写人：许哲玮

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。



观点摘要

目前，一体成型电感行业正处于“量价齐升”的黄金发展期。市场需求在AI服务器、汽车电子、高端消费电子等领域的强劲拉动下持续放量，同时产品结构向大电流、高频化、小型化的高性能方向升级，推动均价显著提升。同时，以麦捷科技、顺络电子为代表的中国厂商加速切入高端供应链，在AI服务器和800V电驱系统中实现批量供货，加快国产替代进程。此外，铜铁共烧等前沿工艺技术虽仍处于早期阶段，但已成为下一代高功率密度电感的重要探索方向。本报告将重点梳理中国一体成型电感行业的发展历程、原料工艺、企业布局，并对该行业的细分赛道现状及规模做出具体分析。此研究将会回答的关键问题包括：1) 一体成型电感的核心原材料是什么？如何进行原材料选型？2) 一体成型电感主要面向哪些细分赛道？各细分赛道的市场现状如何？规模有多大？

✓ **金属磁粉芯是一体成型电感中软磁材料的主流选择**

软磁材料在一体成型电感原材料成本中占比60%-70%，是影响其成本结构的重要因素；对比各软磁材料的饱和磁感应强度和适用频率范围可以发现，金属磁粉芯相对其他软磁材料兼具较高饱和磁感应强度与良好的中高频特性，能有效支撑大功率电源设计，避免电感在大电流下快速饱和，保障电源稳定性，尤其适配于AI服务器、新能源汽车等高功率密度电源场景对小型化、高效率电感的需求，目前已成为一体成型电感中软磁材料的主流选择。

✓ **铜铁共烧是一体成型电感的前沿制备工艺**

目前冷压与热压是一体成型电感的主流制备工艺。相较于冷压与热压工艺，一体成型电感铜铁共烧工艺凭借高温烧结的致密复合结构，在性能与结构方面优势显著，但受材料、工艺、成本、标准等因素制约，目前仍处于小众应用阶段。

✓ **一体成型电感国产化替代进程加速**

中国一体成型电感行业已形成以顺络电子、麦捷科技等为代表的第一梯队，这些国内龙头厂商凭借技术研发、垂直整合与生产设备国产化优势，正加速推动产品进口替代与全球市场竞争力提升。目前，中国一体成型电感龙头厂商的生产设备国产化率已普遍超过70%。

✓ **5G手机、新能源汽车、AI服务器是驱动一体成型电感市场扩张的重要引擎**

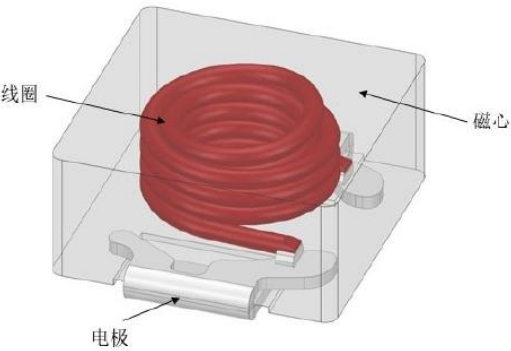
5G手机、新能源汽车、AI服务器市场的快速渗透与发展带动一体成型电感市场需求显著提升，同时推动一体成型电感性能持续升级。在需求扩容与价值升级的双重驱动下，一体成型电感市场将在较快增速下实现规模化扩张。

■ 一体成型电感的定义与分类

一体成型电感是一种采用磁性粉末压铸成型，将线圈完全嵌入并封装在磁性体内的电感器，在大电流承载能力、低直流电阻、全磁屏蔽抗EMI性能及高可靠性等方面要显著优于绕线、叠层和薄膜电感。

■ 一体成型电感是一种采用磁性粉末（通常是羰基铁粉或合金磁粉）压铸成型，将线圈完全嵌入并封装在磁性体内的电感器，主要由磁心、线圈与电极三大核心构件组成。相较于绕线电感、叠层电感、薄膜电感等其他主流电感技术工艺，一体成型电感凭借其全屏蔽结构、超低直流电阻、高饱和电流和优异高频性能，目前已广泛应用于AI服务器、新能源汽车、5G基站等大功率、高密度、低EMI的电源场景中，是功率电感的核心升级方向。

一体成型电感的构成



三大核心构件选型的重要性

- 磁心的饱和磁通密度（Bs）和磁导率直接决定电感的饱和电流能力、直流偏置特性及高频损耗，高Bs低损耗合金可提升电感功率密度与效率；
- 线圈的截面积、绕制结构与纯度影响直流电阻（DCR），低DCR设计可显著降低温升并提高大电流下的能效；
- 电极的附着力、导电性与焊接可靠性决定了电感在高热应力与机械振动环境下的长期稳定性，不良电极易引发虚焊或开路失效，需匹配下游产品的焊接工艺与使用环境

一体成型电感与其他主流电感技术工艺对比

工艺类型	工艺原理与结构	优点	缺点
绕线电感	通过精密绕线机将漆包线绕制于磁芯（铁氧体或金属磁粉芯）表面	- 功率大，可承受高电流，饱和电流高 - 性能稳定，可靠性高 - 技术成熟，成本较低	- 体积大，难以高度微型化 - 存在寄生效应 - 磁芯可能产生电磁干扰
叠层电感	采用多层印刷与叠层烧结技术将导电浆料和磁性浆料交替叠层印刷、烧结，形成螺旋线圈结构	- 尺寸小，适合高密度贴装 - 高频特性，寄生电容小 - 机械强度高，无裸露线，可靠性好 - 自动化生产，一致性好	- 电流容量相对较小 - 电感量和Q值通常低于同尺寸绕线电感 - 大电流下易发热
薄膜电感	采用半导体光刻工艺在硅、陶瓷或玻璃基板上制作微米级线圈	- 尺寸精细且精度高 - 自谐振频率较高，适合超高频应用 - 批次一致性好	- 生产设备投入成本高 - 电感量和电流容量有限 - 工艺复杂
一体成型电感	将绕组本体埋入金属磁性粉末内压铸	- 高结构强度和可靠性 - 磁屏蔽性强，EMI低 - 高密度、大电流，直流电阻低 - 小型化与高集成，可将多个线圈同时成型实现多电感集成	- 磁粉配方与压制工艺门槛高 - 成本较高 - 外形尺寸相对固定

来源：华中科技大学，昂洋科技，谷景电感，华金硕科技，头豹研究院

■ 一体成型电感产业链图谱

一体成型电感产业链上游为原材料与设备供应环节，其中软磁材料是关键原材料；中游为电感设计、制造与封装环节，构成价值链核心；下游面向AI算力、新能源汽车、5G通信等应用场景。

■ 产业链上游：原材料与设备供应

- 产业链价值量占比：30%-40%
- 核心价值体现：磁性粉末配方决定电感的频率特性、电流能力和小型化极限；高精度设备如压铸、绕线、检测设备保障电感生产质量、良率与效率
- 特征：技术壁垒高，掌握高端磁粉及设备的头部企业享有较高毛利率；材料价格对铜、铁等大宗商品敏感

■ 产业链中游：电感设计、制造与封装

- 产业链价值量占比：40%-50%
- 核心价值体现：磁路设计与工艺优化Know-how决定电感性能上限；微米级精度工艺保障电感良率与一致性；强定制化能力能够快速匹配并响应客户电源设计需求
- 特征：资本与技术密集；头部企业在采购成本、生产效率和良率控制上优势显著；车规级认证周期长，客户粘性高；高端产品定制化程度较高

■ 产业链下游：应用终端与模组集成

- 产业链价值量占比：10%-30%
- 核心价值体现：车载、AI服务器等高附加值应用场景驱动电感技术迭代；品牌溢价与生态绑定；参与电源管理模块的集成化设计
- 特征：应用领域高度分散；新能源汽车、数据中心等高增长赛道的需求驱动明确，对电感的可靠性、一致性和交付能力要求较高

一体成型电感产业链图谱



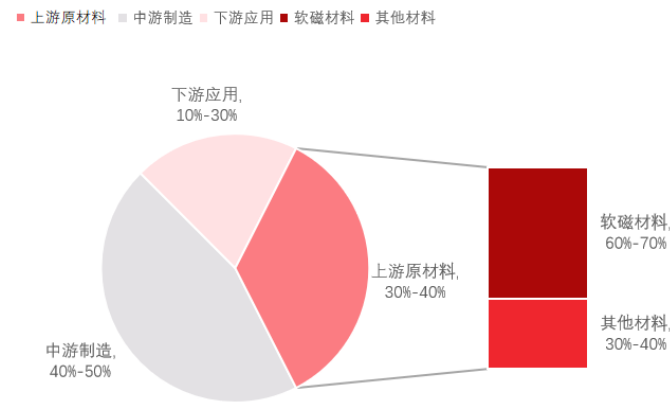
来源：各企业官网，铂科新材，头豹研究院

■ 一体成型电感的原材料选型（1/2）

软磁材料在一体成型电感原材料成本中占比60%-70%，是影响其成本结构的重要因素；金属磁粉芯相对其他软磁材料兼具较高饱和磁感应强度与良好的中高频特性，是一体成型电感中软磁材料的主流选择。

- 在一体成型电感产业链中，上游原材料价值占比达30%-40%，是产业链价值的核心承载环节，而软磁材料作为决定电感高频损耗、饱和电流等关键性能的核心原料，在上游原材料成本中占比达60%-70%，是原材料成本结构的主导因素。
- 软磁材料主要可分为金属软磁、铁氧体软磁和非晶/纳米晶三类，其中金属软磁可进一步细分为电工纯铁、硅钢、坡莫合金、金属磁粉芯等类别。对比各软磁材料的饱和磁感应强度和适用频率范围可以发现，金属磁粉芯相对其他软磁材料兼具较高饱和磁感应强度与良好的中高频特性，能有效支撑大功率电源设计，避免电感在大电流下快速饱和，保障电源稳定性，尤其适配于AI服务器、新能源汽车等高功率密度电源场景对小型化、高效率电感的需求，目前已成为一体成型电感中软磁材料的主流选择。

一体成型电感产业链价值量分布及软磁材料在上游原材料成本中占比



各软磁材料的饱和磁感应强度及适用频率范围对比



来源：晨欣电子，金属功能材料，春光科技集团，头豹研究院

■ 一体成型电感的原材料选型（2/2）

- 目前，羰基铁粉芯与铁硅铬磁粉芯凭借较强的大电流抗饱和能力、高磁导率、低损耗等高性能及低成本的优势而成为一体成型电感主要应用的金属磁粉芯类型。
- 羰基铁粉芯与铁硅铬磁粉芯是目前一体成型电感主要应用的金属磁粉芯类型。在众多金属磁粉芯材料中，羰基铁粉芯的饱和磁感应强度最高，在大电流场景下的抗饱和能力突出，但存在磁导率低、耐腐蚀性差等不足，需通过涂层等后处理来改善耐盐雾和耐湿气性；铁硅铬磁粉芯虽饱和磁感应强度略低，但磁导率较高，且铬元素的加入在提高抗锈蚀、抗老化性能的同时可有效抑制涡流损耗。综合来看，二者主要凭借显著的性能优势而占据市场主流地位。
 - 反观其他金属磁粉芯材料，纯铁磁粉芯受制于高频涡流损耗大；铁硅磁粉芯用于一体成型电感时需特殊粘结剂辅助成型而难以形成优质包覆层，导致磁性能与成型稳定性不足；铁硅铝磁粉芯局限于饱和磁感应强度较低，大电流下易磁饱和且直流偏置性能较差；铁镍铝磁粉芯因成本过高而难以大规模推广；非晶/纳米晶磁粉芯仍面临工艺复杂且脆性大、成型致密度低等挑战，短期应用受限。

不同金属磁粉芯性能对比

类型	成分	测试条件: 100mT, 50kHz		饱和磁感应强度 (T)	直流偏置特性@100G	成本
		直流磁导率	损耗 (mW/cm³)			
纯铁磁粉芯	100%Fe	30-75	800-1000	0.50-1.40	40%	最低
羰基铁粉芯	80%Fe-20%Ni	30-75	300-600	2.00-2.20	90%	低
铁硅磁粉芯	92.5%Fe-6.5%Si	20-30	100-300	1.50	70%	低
铁硅铬磁粉芯	80%Fe-10%Si-2%Cr	14-20	100-300	1.50	80%	低
铁硅铝磁粉芯	85%Fe-10%Si-5%Al	14-20	100-300	0.75	90%	中
铁镍铝磁粉芯	81%Fe-17%Ni-2%Al	14-20	200-300	0.75	90%	高
非晶磁粉芯	Fe ₇₃ Si ₁₃ B ₉	20-30	200-300	1.50	80%	中
纳米晶磁粉芯	Fe _{73.5} Si _{13.5} Al ₃ Cu ₁ Nb _{0.5}	20-30	200-300	1.25	70%	中

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2025年中国一体成型电感行业概览》

来源：功能材料与器件学报，腾业，头豹研究院

■ 一体成型电感的制备工艺（1/3）

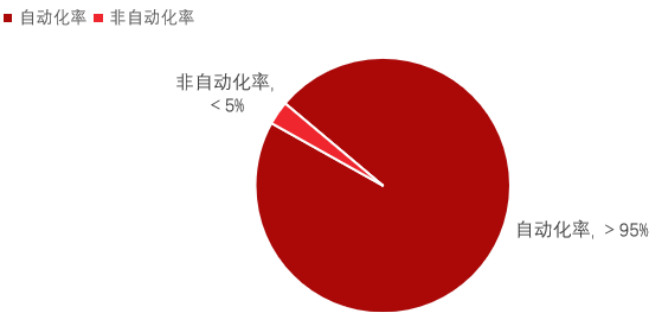
一体成型电感冷压工艺是一种在室温下将绕线骨架与绝缘包覆金属磁粉高压成型并辅以树脂封装的成熟制造技术，具备工序简单、高自动化、低成本的特点，适用于中低端、小功率、成本敏感型场景。

- 冷压工艺是目前一体成型电感产业端最成熟、量产效率最高且设备投资最低的技术路线。在冷压工艺中，一体成型电感的制备包括绕制线圈、焊接线圈、压制成型、烘烤固化、表面处理、弯折引脚、外观检查、测试包装等流水线路序。首先，需要根据设计要求确定线圈的绕制参数，在绕线架上进行线圈绕制；随后将绕制好的线圈使用电流熔焊接到镀锡铜片引脚上；将制备好的线圈置于成型模具内，采用压制成型的方式将软磁粉末填充到线圈周围；然后将填充好绝缘材料的电感压胚进行烘烤固化处理；再对其进行喷砂、喷漆、喷码等表面处理，剪去多余料片；接着将电感两侧端脚进行弯折，使其平贴于电感表面；最后检查电感外观，对满足要求的电感进行电感值、电阻等电气性能参数测试，确认无误后对成品进行包装存储。
- 现阶段一体成型电感冷压工艺的整体工序自动化率已达95%以上，基本实现全流程自动化。从磁粉计量、线圈自动上料、冷压成型到环氧模塑封装、成品取放等环节均可由精密自动化设备完成，无需大量人工干预，既能避免人工操作导致的填粉不均、线圈错位等问题，又能显著提升生产效率与产品一致性，为大规模、标准化的成本敏感型市场提供了有力支撑。

一体成型电感冷压工艺流程（以铭普光磁为例）



一体成型电感冷压工艺自动化水平，截至2025年4月



来源：铭普光磁，电子变压器与电感网，头豹研究院

■ 一体成型电感的制备工艺（2/3）

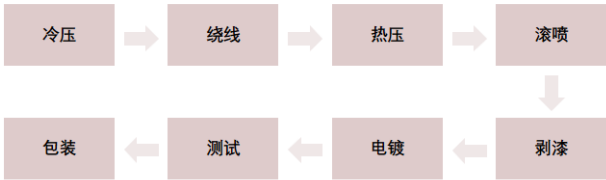
一体成型电感热压工艺可破解冷压工艺物理结合的固有弱点所导致的产品机械可靠性、功率密度不足与一体成形小型化难题，其中冷压预制+热压成型的两步法热压工艺是中高端场景的主流选择。

- 在电子设备小型化、大电流需求升级的驱动下，一体成型电感制备工艺逐步从传统冷压向热压演进。热压工艺通过加热加压形成的强固化学-物理结合网络，可破解冷压工艺物理结合的固有弱点所导致的产品机械可靠性、功率密度不足与一体成形小型化难题。热压工艺根据工序复杂性不同可分为一步法热压与两步法热压，相较于直接热压成型，冷压预制+热压成型工艺能有效解决其高温压制易破坏磁粉绝缘层、填粉不均的痛点，进一步提升磁芯致密度、机械强度、磁性能与良率。目前，一步法热压已逐步被边缘化，两步法热压则凭借性能、良率、可制造性的综合优势，成为AI算力、车规电子、通信设备等中高端场景的主流选择。
- 在“超薄小尺寸”一体成型电感设计中，T-Core结构（即线圈置于磁芯中央、上下磁轭形成闭合“T”形磁路）已成为主流，主要得益于其在电磁性能与制造工艺上的双重优势，在大电流下磁通分布均匀且结构在压制过程中受力均衡，不易变形，契合高密度、高一致性量产需求。一体成型电感冷压预制+热压成型工艺历经冷压制成T-Core磁芯坯体、绕线、热压、滚喷、剥漆、电镀、测试与包装多道工序，其中热压成型是关键步骤，关乎是否能实现磁芯致密化与线圈无缝包覆，直接决定电感的性能与可靠性。

一体成型电感“一步法热压工艺”与“两步法热压工艺”的对比

类型	一步法热压	两步法热压
工艺流程	将绕制好的线圈与磁粉直接在加热模具中一次高温高压压制成型	先在室温下冷压预制成生坯，再将此预制坯和线圈放入已加热的模具中进行最终的加热加压成型
核心优势	• 设备与工序相对简单，单次成型效率高 • 磁粉致密度、抗饱和能力与功率密度优于传统冷压	• 结合冷压与热压优点，磁芯致密度、机械强度、磁性能与良率优于纯热压 • 成型精度高，适配复杂结构电感生产
局限与挑战	• 高温易破坏部分磁粉绝缘包覆层，需精准控温 • 混合料直接热压易出现填粉不均，影响产品一致性 • 工艺控制难度大，良率风险高	• 流程更复杂，增加了预制和转移工序，工艺调试周期更长、设备投入和生产成本更高 • 生坯转运过程存在破损风险 • 量产效率低于纯热压工艺
应用现状	难以兼顾一致性、良率和性能，应用逐渐被两步法热压工艺替代	中高端应用的主流路线

一体成型电感冷压预制+热压成型工艺流程（以T-Core结构为例）



来源：震东电子，时源芯微，头豹研究院

■ 一体成型电感的制备工艺（3/3）

相较于冷压与热压工艺，一体成型电感铜铁共烧工艺凭借高温烧结的致密复合结构，在性能与结构方面优势显著，但受材料、工艺、成本、标准等因素制约，目前仍处于小众应用阶段。

- 相较于主流的冷压与热压工艺，一体成型电感铜铁共烧工艺具备多项突出优势。首先，在性能层面，经高温烧结形成的致密复合结构可消除传统模压工艺中环氧树脂带来的热阻与老化风险，显著提升饱和磁感应强度、导热性和长期可靠性，总损耗也大幅降低。在相同尺寸条件下，铜铁共烧电感的电感量与Q值分别较传统模压电感与组装式电感提升1.3-2倍和1.5-3倍。其次，在结构层面，铜铁共烧工艺可实现电感高度薄化，小型化程度更高。在相同电气条件下，铜铁共烧电感高度较组装式电感降低50%-60%，较传统模压电感降低30%-40%。然而，当前铜铁共烧工艺仍处于小众应用阶段，主要归因于材料适配与工艺控制难、生产成本高、标准缺失等制约因素。

传统模压电感、组装式电感、铜铁共烧电感的电气特性与尺寸对比*

方案	电气特性				尺寸		
	电感量/nH	Q	DCR/mΩ	饱和电流/A(Max.)	长/mm	宽/mm	高/mm
传统模压电感	150	20-40	0.40	50	11.5	8.0	3.9
组装式电感	150	15-20	0.40	50	11.5	7.4	7.5
铜铁共烧电感	150	40-60	0.40	50	11.5	7.4	2.6
传统模压电感	50	20-40	0.34	40	10.0	4.0	2.3
组装式电感	75	15-20	0.30	65	10.0	4.0	2.3
铜铁共烧电感	100	40-60	0.30	57	10.0	4.0	2.3

目前制约铜铁共烧工艺规模化应用的主要因素

➤ 材料适配难

铜绕组在高温烧结时易氧化，若采用涂覆抗氧化涂层或氮氢混合气氛保护，会大幅增加研发难度及设备与运维成本；高性能磁性材料退火温度高，现有绕组绝缘材料耐温性不足，制约材料选择范围。

➤ 生产成本高昂

工艺需配备高精度压力成型机、气氛烧结炉等专用设备及专用模具，研发及采购成本高昂；同时，铜铁共烧成品成型性差及良品率低进一步推高单位生产成本。

➤ 工艺控制难度高

铜与铁基材料的烧结收缩率差异显著，两者在烧结过程中的热膨胀系数和收缩率需高度匹配，否则易导致成品出现开裂、分层、变形等问题，因此对烧结氛围、温度曲线等参数控制精度要求严苛。

➤ 缺乏成熟供应链与标准体系

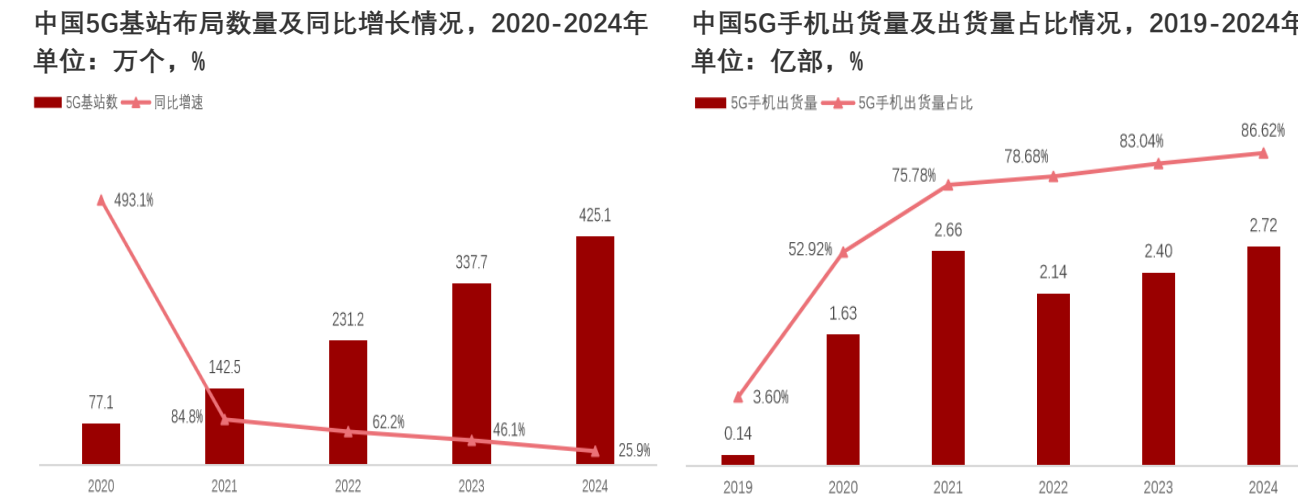
上游高性能铜铁复合粉、耐高温绝缘涂层等核心材料供应不稳定，中游专用设备与模具依赖定制化开发，下游需求分散，且行业内尚未形成统一的材料规范、工艺参数与可靠性测试标准。

*其中铜铁共烧电感以顺络电子HTF系列产品为例
来源：顺络电子，电子变压器与电感网，头豹研究院

■ 一体成型电感细分赛道5G手机市场现状及规模

得益于5G手机快速渗透及其对小尺寸、高性能电感的需求持续提升，2021-2024年中国5G手机用一体成型电感市场规模实现较快增长，未来在技术迭代与市场深化影响下将有望打开新的增长空间。

- 5G基站的大规模部署与5G手机的全面普及显著提升了对高频、小型化、高可靠性一体成型电感的需求，驱动一体成型电感市场扩容与技术升级，成为支撑5G硬件发展的重要增量元件市场。
- 2021-2024年，中国5G手机用一体成型电感市场规模整体呈现快速增长态势，市场规模从20.85亿元提升至36.99亿元，年均复合增长率达21.06%，主要受益于5G手机快速渗透及其对小尺寸、高性能电感的需求持续提升。
- 预计2025-2030年，中国5G手机用一体成型电感市场仍将维持较快增长，市场规模将从47.94亿元增长至124.00亿元，年均复合增长率为20.93%，其动力主要源于技术迭代与市场深化。



来源：金融界，传感器专家网，东方财富网，中国信通院，立创商城，头豹研究院

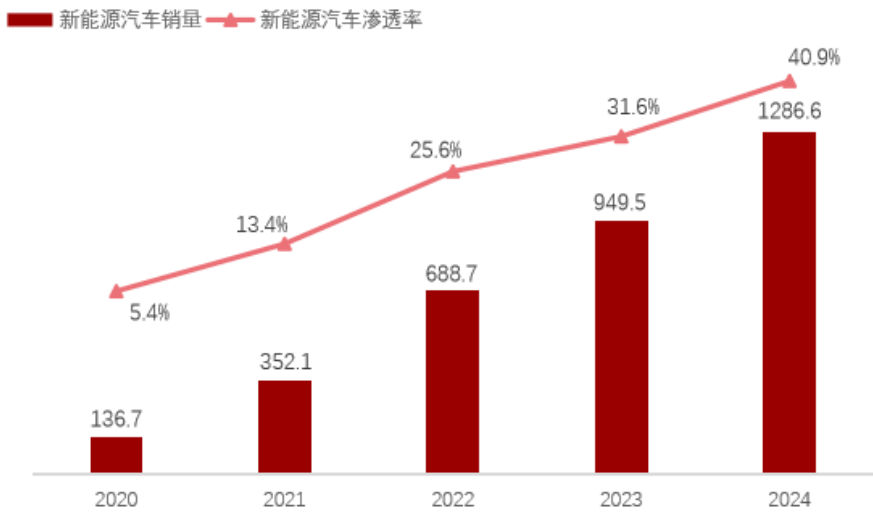
■ 一体成型电感细分赛道新能源汽车市场现状及规模

新能源汽车市场的快速发展显著提升单车一体成型电感用量并带动一体成型电感性能升级，成为推动其市场规模持续高速扩张的核心驱动力。

- 2020-2024年，中国新能源汽车销量与渗透率呈阶梯式跃升。一体成型电感凭借其高电流密度、低损耗、强抗电磁干扰能力及高可靠性的核心优势，现已成为新能源汽车各类电子电气系统中不可或缺的关键被动元件。一体成型电感主要应用于动力系统、车身控制、智能座舱、ADAS、网络通信等核心车载模块。
- 2021-2024年，中国新能源汽车用一体成型电感市场呈现爆发式增长，市场规模从1.69亿元增长至26.39亿元，年均复合增长率达149.95%，核心驱动力源于新能源汽车产销量与渗透率的快速提升。
- 预计2025-2030年，中国新能源汽车用一体成型电感市场仍将快速增长，市场规模将从39.47亿元增长至131.19亿元，年均复合增长率为27.15%，核心逻辑在于需求扩容与技术升级的双重驱动。

中国新能源汽车销量及新能源汽车渗透率情况，2020-2024年

单位：万辆，%



中国新能源汽车用一体成型电感市场规模，2021-2030E

单位：亿元



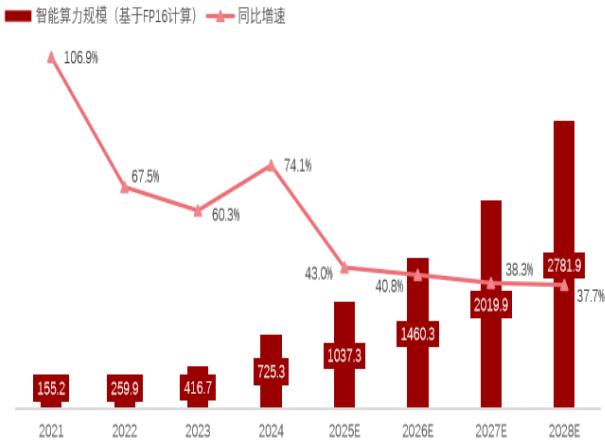
来源：中汽协，科达嘉电子，上汽集团，乘联会，阿赛姆电子，立创商城，头豹研究院

■ 一体成型电感细分赛道AI服务器市场现状及规模

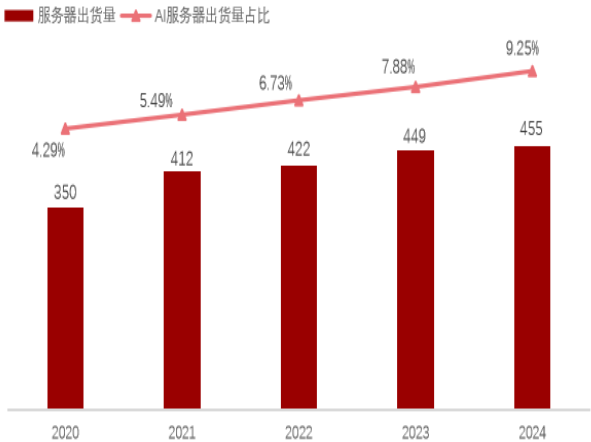
AI服务器市场的蓬勃发展直接推动一体成型电感市场实现从通用需求到高价值、高性能专用市场的结构性扩张，是其市场扩容与技术迭代的关键引擎。

- 中国智能算力规模扩张推动AI服务器快速渗透，将显著提升一体成型电感的单机用量与产品附加值，驱动一体成型电感市场实现量价齐升与应用场景扩容。
- 2021-2024年，中国AI服务器用一体成型电感市场实现较快增长，市场规模从0.49亿元增长至1.67亿元，年均复合增长率达50.49%，核心驱动力来自于AI算力基础设施建设的爆发及单机需求的结构性升级。
- 预计2025-2030年，中国AI服务器用一体成型电感市场仍将延续强劲增长趋势，市场规模将从2.63亿元增长至17.45亿元，年均复合增长率为46.01%，主要受益于智能算力需求持续爆发。

中国智能算力规模及同比增长情况预测，2021-2028E
单位：EFlops



中国服务器出货量及AI服务器出货量占比情况，2020-2024年
单位：万台，%



中国AI服务器用一体成型电感市场规模，2021-2030E

单位：亿元



来源：IDC，电子变压器与电感网，立创商城，头豹研究院

未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业研究团队

邮箱：

sharlin.chen@leadleo.com

18129990784

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2025年中国一体成型电感行业概览》

了解其他电子元件系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 市场洞察：工业传感器深度重构，细分赛道掘金与国产替代加速
- 市场洞察：超强导电，碳纳米管为何成为材料界新宠？
- 2024年中国压力传感器行业探析
- 2024年中国温度传感器行业探析
- 2024年中国压力传感器行业探析
- 2024年中国惯性传感器行业短报告

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和
百万数据，提供数据库
API接口服务

定制报告

行企研究多模态搜索引
擎及数据库，募投可研、
尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行
现状梳理和趋势洞察，
输出全局观深度研究报
告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核
心产业，内容可授权引
用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评
估和调研确认，助力企
业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，
帮助学生掌握行业研究
能力，丰富简历履历

报告作者



陈夏琳
首席分析师
sharlin.chen@leadleo.com



许哲玮
行业分析师
jarvis.xu@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com



商务咨询与深度合作

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街
道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号
会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济开
发区兴智科技园B栋401

邮编：210046

2026 福布斯中国行业发展领创者评选

2026 FORBES CHINA PIONEER INNOVATORS IN
INDUSTRY DEVELOPMENT SELECTION

百年福布斯 权威标杆

行业最具影响力的荣誉殿堂



<覆盖核心赛道>

AI科技 | 新能源 | 医疗健康 | 大消费 | 制造业 | 服务业



<全球媒体矩阵传播>

赋能个人与品牌，提升市场影响力



<设立多重荣誉>

①主评选：行业发展领创者

②子评选：领军企业 / 创新品牌 / ESG标杆
/ AI企服标杆 / 新锐分析师